

中国集成电路封装需求现状与发展动态分析报告2021-2026年

产品名称	中国集成电路封装需求现状与发展动态分析报告 2021-2026年
公司名称	北京中研智业信息咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区北苑东路19号院4号楼27层2708（ 注册地址）
联系电话	010-57126768 15263787971

产品详情

中国集成电路封装需求现状与发展动态分析报告2021-2026年【报告编号】：324393【出版时间】：

2021年1月【出版机构】：中研智业研究院【交付方式】：EMIL电子版或特快专递

【报告价格】：【纸质版】：6500元【电子版】：6800元【纸质+电子】：7000元【联系人】：

杨静--客服专员【报告来源】：<http://www.zyzyjy.com/baogao/324393.html>

免费售后服务一年，具体内容及订购程欢迎咨询客服人员。

【报告目录】第1章：中国集成电路封装行业发展背景1.1 集成电路封装行业定义及分类1.1.1 集成电路封装界定（1）集成电路封装产业概念（2）集成电路封装产业链位置（3）集成电路封装作用1.1.2 集成电路封装行业产品分类（1）按功能分类（2）按集成度分类（3）按封装外形分类1.1.3 集成电路封装行业特性分析（1）行业周期性失灵（2）行业区域性（3）行业季节性1.2 集成电路封装行业政策环境分析1.2.1 行业管理体制（1）主管部门（2）行业协会1.2.2 行业相关政策1.3 集成电路封装行业经济环境分析1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析（1）国际宏观经济现状（2）国际宏观经济展望（3）全球GDP与集成电路相关性1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析（1）中国GDP及增长情况分析（2）中国工业经济增长分析（3）我国GDP与集成电路封装行业的关联性分析（4）居民收入水平1.3.3 居民收入与行业的相关性1.4 集成电路封装行业技术环境分析1.4.1 集成电路封装技术演进分析1.4.2 集成电路封装形式应用领域1.4.3 集成电路封装工艺流程分析1.4.4 集成电路封装行业新技术动态（1）WLCSP封装（2）3D封装技术（3）SiP封装（4）倒装技术第2章：中国集成电路产业发展分析2.1 集成电路产业发展状况2.1.1 集成电路产业简介（1）集成电路产业链（2）集成电路业务示意图2.1.2 集成电路产业发展现状（1）集成电路销售规模（2）集成电路结构2.1.3 集成电路产业三大区域分析（1）集成电路产业分布特征（2）集成电路产业布局发展趋势（3）未来集成电路产业空间布局2.1.4 集成电路产业面临挑战、发展途径以及发展前景（1）集成电路产业当下存在问题（2）集成电路产业“十四五”面临挑战（3）集成电路产业“十四五”发展途径（4）集成电路产业发展前景2.1.5 集成电路产业发展预测（1）战略性新兴产业将加速发展（2）资本市场将为企业融资提供更多机会2.2 集成电路设计业发展状况2.2.1 集成电路设计业发展概况2.2.2 集成电路设计业行业发展现状（1）产业发展增速减缓增幅合理（2）企业数量不断增加（3）产业集中度提高（4）技术能力大幅提升2.2.3 集成电路设计业行业政策分析2.2.4 集成电路设计业发展策略分析2.2.5 集成电路设计业“十四五”发展预测（1）产业规模（2）企业建设（3）技术水平2.3

集成电路制造业发展状况2.3.1 集成电路制造业发展概况2.3.2 集成电路制造业发展现状分析(1) 集成电路制造行业供给情况分析(2) 集成电路制造行业需求情况分析(3) 全国集成电路制造行业产销率分析(4) 集成电路制造业发展主要特点2.3.3

集成电路制造业“十四五”发展预测第3章：中国集成电路封装行业发展分析3.1

中国集成电路封装行业发展历程3.2 中国集成电路封装行业发展现状3.2.1 集成电路封装行业规模分析3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析(1) 区域分布现状(2) 企业现状3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析(1) 有利因素(2) 不利因素3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测(1) 发展趋势分析(2) 前景预测3.3 半导体封装发展情况分析3.3.1 半导体行业发展概况3.3.2 半导体行业景气预测(1) 市场需求方面(2) 技术与产品更新方面3.3.3 半导体封装发展分析(1) 封装环节产值逐年成长(2) 封装环节外包是未来发展趋势3.4 集成电路封装类专利发展情况分析3.4.1 专利申请数量趋势3.4.2 专利公开数量趋势3.4.3 技术分类趋势分布3.4.4 主要权利人分布情况3.5 集成电路封装过程部分技术问题探讨3.5.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策(1) 封装开裂的影响因素分析(2) 管控影响开裂的因素的方法分析3.5.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策(1) 产生芯片弹坑问题的因素分析(2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第4章：中国集成电路封装市场产品及需求分析4.1 集成电路封装行业主要产品分析4.1.1 BGA产品市场分析(1) BGA封装技术(2) BGA产品主要应用领域(3) BGA产品需求拉动因素(4) BGA产品市场应用现状分析(5) BGA产品市场前景展望4.1.2 SIP产品市场分析(1) SIP封装技术(2) SIP产品主要应用领域(3) SIP产品需求拉动因素(4) SIP产品市场应用现状分析(5) SIP产品市场前景展望4.1.3 SOP产品市场分析(1) SOP封装技术(2) SOP产品主要应用领域(3) SOP产品市场发展现状(4) SOP产品市场前景展望4.1.4 QFP产品市场分析(1) QFP封装技术(2) QFP产品主要应用领域(3) QFP产品市场发展现状(4) QFP产品市场前景展望4.1.5 QFN产品市场分析(1) QFN封装技术(2) QFN产品主要应用领域(3) QFN产品市场发展现状(4) QFN产品市场前景展望4.1.6 MCM产品市场分析(1) MCM封装技术水平概况(2) MCM产品主要应用领域(3) MCM产品需求拉动因素(4) MCM产品市场发展现状(5) MCM产品市场前景展望4.1.7 CSP产品市场分析(1) CSP封装技术水平概况(2) CSP产品主要应用领域(3) CSP产品市场发展现状(4) CSP产品市场前景展望4.1.8 其他产品市场分析(1) 晶圆级封装市场分析(2) 覆晶/倒封装市场分析(3) 3D封装市场分析4.2 集成电路封装行业市场需求分析4.2.1 计算机领域对行业的需求分析(1) 计算机市场发展现状(2) 集成电路在计算机领域的应用(3) 计算机领域对行业需求的拉动4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析(1) 消费电子市场发展现状(2) 消费电子领域对行业需求的拉动4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析(1) 通信设备市场发展现状(2) 集成电路在通信设备领域的应用(3) 通信设备领域对行业需求的拉动4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析(1) 工控设备市场发展现状(2) 集成电路在工控设备领域的应用1) 工业机器人2) 变频器3) 传感器4) 工控机5) 机器视觉6) 3D打印7) 运动控制器(3) 工控设备领域对行业需求的拉动4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析(1) 汽车电子市场发展现状(2) 集成电路在汽车电子领域的应用(3) 汽车电子领域对行业需求的拉动4.2.6 医疗电子领域对行业的需求分析(1) 医疗器械制造业发展情况(2) 集成电路在医疗电子领域的应用(3) 医疗电子领域应用前景分析

第5章：集成电路封装行业市场竞争分析5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析(1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本(2) 主板材料的变化趋势5.1.4 国际集成电路封装行业扶持措施借鉴5.2 跨国企业在华市场竞争力分析5.2.1 台湾日月光投资控股股份竞争力分析(1) 企业发展简介(2) 企业组织架构(3) 企业财务情况分析(4) 企业主营产品及应用领域(5) 企业市场区域及行业地位分析(6) 企业在中国市场投资布局情况(7) 企业最新动态5.2.2 美国安靠(Amkor)公司竞争力分析(1) 企业发展简介(2) 企业主营产品及应用领域(3) 企业市场区域及行业地位分析(4) 企业在中国市场投资布局情况5.2.3 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析(1) 企业发展简介(2) 企业经营情况分析(3) 企业主营产品及应用领域(4) 企业市场区域及行业地位分析(5) 企业在中国市场投资布局情况5.2.4 力成科技股份有限公司竞争力分析(1) 企业发展简介(2) 企业经营情况分析(3) 企业主营产品及应用领域(4) 企业市场区域及行业地位分析(5) 企业在中国市场投资布局情况5.2.5 飞思卡尔公司竞争力分析(1) 企业发展简介(2) 企业主营产品及应用领域(3) 企业市场区域及行业地位分析(4) 企业在中国市场投资布局情况5.2.6 英飞凌科技公司竞争力分析(1) 企业发展简介(2) 企业主营产品及应用领域(3) 企业市场区域及行业地位分析(4) 企业在中国市场投资布局情况5.3

集成电路封装行业国内竞争格局分析5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析5.3.2
中国集成电路封装行业国际竞争力分析5.4 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析5.4.1
现有竞争者之间的竞争5.4.2 上游议价能力分析5.4.3 下游议价能力分析5.4.4 行业潜在进入者分析5.4.5
替代品风险分析5.4.6 行业竞争五力模型总结第6章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析6.1
集成电路封装企业发展总体状况分析6.2 集成电路封装行业重点企业个案分析6.2.1 上海华岭集成电路技术
股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析1）主要经营指标分析2）企
业盈利能力分析3）企业运营能力分析4）企业偿债能力分析5）企业发展能力分析（3）企业运营业务情
况分析（4）企业技术及资质发展情况（5）企业产品结构分析（6）企业优劣势分析（7）企业zui新发展
动态分析6.2.2 山东齐芯微系统科技股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业股权结
构分析（3）企业经营状况分析1）主要经营指标分析2）企业盈利能力分析3）企业运营能力分析4）企业
偿债能力分析5）企业发展能力分析（4）企业产品结构分析（5）企业优劣势分析（6）企业zui新发展动
态分析6.2.3 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业股权结
构分析（3）企业发展商业模式分析（4）企业发展面临风险情况分析（5）企业经营状况分析1）主要经
营指标分析2）企业盈利能力分析3）企业运营能力分析4）企业偿债能力分析5）企业发展能力分析（6）
企业产品结构分析（7）企业优劣势分析（8）企业zui新发展动态分析6.2.4 南通华隆微电子股份有限公司
经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业股权结构情况（3）企业商业模式分析（4）企业发展面
临风险情况分析（5）企业经营状况分析1）主要经营指标分析2）企业盈利能力分析3）企业运营能力分
析4）企业偿债能力分析5）企业发展能力分析（6）企业产品结构分析（7）企业优劣势分析6.2.5 上海芯
哲微电子科技股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析1）主要经营指
标分析2）企业盈利能力分析3）企业运营能力分析4）企业偿债能力分析5）企业发展能力分析（3）企业
产品结构及新产品动向（4）企业销售渠道与网络（5）企业经营状况优劣势分析6.2.6 深圳电通纬创微电
子股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构及新产
品动向（4）企业销售渠道与网络（5）企业经营状况优劣势分析6.2.7 江苏长电科技股份有限公司经营情
况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析1）主要经营指标分析2）企业盈利能力分析3）企
业运营能力分析4）企业偿债能力分析5）企业发展能力分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场
分析（5）企业营销网络分析（6）企业技术水平分析（7）企业核心竞争力分析（8）企业发展优劣势分
析（9）企业zui新发展动向6.2.8 苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析1）主要经营指标分析2）企业盈利能力分析3）企业运营能力分析4）企业偿债能
力分析5）企业发展能力分析（3）企业产品结构分析。（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析
（6）企业新产品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析
（10）企业zui新发展动向6.2.9 天水华天科技股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企
业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业新产
品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析（10）企业zui新
发展动向6.2.10 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情
况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业新产品动向分
析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析（10）企业zui新发展动向6.
2.11 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业
组织架构分析（4）企业产品结构及新产品动向（5）企业销售渠道与网络（6）企业经营状况优劣势分析
6.2.12 大唐微电子技术有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企
业产品结构及新产品动向（4）企业销售渠道与网络（5）企业经营状况优劣势分析（6）企业zui新发展动
向分析6.2.13 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3
）企业产品结构及新产品动向（4）企业销售渠道与网络（5）企业经营状况优劣势分析6.2.14 安靠封装测
试（上海）有限公司经营情况分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构及
新产品动向（4）企业销售渠道与网络（5）企业经营状况优劣势分析第7章：中国集成电路封装行业投资
分析及建议7.1 集成电路封装行业投资特性分析7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒（1）技术壁垒（2）渠道
壁垒（3）人才壁垒（4）市场规模壁垒（5）出口资质壁垒7.1.2 集成电路封装行业盈利模式7.1.3
集成电路封装行业盈利因素7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析7.2.1
集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析7.2.3 国
内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析（1）通富微电公司投资兼并与重组分析（2）华天科技公
司投资兼并与重组分析（3）长电科技公司投资兼并与重组分析7.2.4
集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析7.3 集成电路封装行业投融资分析7.3.1

产业基金对集成电路产业的扶持分析(1)基金对集成电路产业的扶持情况(2)近年来国家产业基金集成电路投资情况(3)电子发展基金对集成电路产业的扶持建议(4)大基金对集成电路产业的投资情况(5)大基金对集成电路产业的投资建议7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析7.3.3

半导体行业资本支出分析7.4 集成电路封装行业投资建议7.4.1

集成电路封装行业投资机会分析(1)宏观环境改善(2)政策的利好(3)产业转移(4)市场因素7.4.2

集成电路封装行业投资风险分析(1)政策风险(2)技术风险(3)供求风险(4)宏观经济波动风险(5)关联产业风险(6)产品结构风险(7)企业生产规模风险(8)其他风险7.4.3 集成电路封装行业投资建议

(1)投资区域建议(2)投资产品建议(3)技术升级建议

图表目录
图表1：封装在集成电路制造产业链中位置
图表2：集成电路封装行业产品分类
图表3：集成电路封装行业产品分类
图表4：集成电路封装产品按封装外形分类
图表5：集成电路封装行业主要政策分析
图表6：2009-2020年美国国内生产总值变化趋势图(单位：十亿美元，%)

图表7：2009-2020年欧元区GDP季度同比增长变化(单位：%)
图表8：2010-2020年日本GDP同比变化(单位：%)
图表9：1980-2023F世界GDP与集成电路市场增长相关关系
图表10：2014-2020年中国国内生产总值情况及增长率(单位：亿元，%)

图表11：2014-2020年我国全部工业增加值及增速(单位：亿元，%)
图表12：2014-2020年中国农村居民人均可支配收入及增长趋势图(单位：元，%)
图表13：2010-2020年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图(单位：元，%)

图表14：集成电路封装技术发展历程
图表15：集成电路封装技术示意图
图表16：集成电路封装技术应用领域
图表17：集成电路封装工艺流程
图表18：集成电路产业链示意图
图表19：集成电路业务模式示意图
图表20：2010-2020年我国集成电路行业销售额增长情况(单位：亿元，%)

图表21：2014-2020我国集成电路行业进出口额情况分析(单位：亿块，亿美元)
图表22：2020年前三季度我国集成电路产业市场规模结构图(按销售额)(单位：%)
图表23：集成电路封装行业产业区域特征分析
图表24：集成电路封装行业产业区域特征分析
图表25：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析
图表26：2021-2026年中国集成电路行业市场规模预测图(单位：亿元)

图表27：2011-2020年国内集成电路设计市场销售收入和增长情况(单位：亿元，%)
图表28：2011-2020年国内集成电路设计企业数量(单位：个)
图表29：2019-2020年国内TOP10 IC设计企业上班门槛及规模占比情况
图表30：集成电路设计行业政策分析
图表31：集成电路设计业新发展策略
图表32：2010-2020年国内集成电路制造行业产量及同比增长率走势(单位：亿块，%)

图表33：2011-2020年国内集成电路制造行业销售收入及增长率变化趋势图(单位：亿元，%)
图表34：2017-2020年国内集成电路制造行业累计产销率变化情况(按产销数量)(单位：%)
图表35：2020年FAB项目情况(硅基项目)
图表36：2020年FAB项目情况(化合物项目)
图表37：集成电路制造业发展主要特点分析
图表38：2011-2020年中国封装测试行业销售收入及增长情况(单位：亿元，%)

图表39：大陆封测厂商与业内领先封测厂商主要技术对比
图表40：2012-2020年全球半导体市场规模及增速(单位：亿美元，%)
图表41：半导体行业景气预测模型
图表42：2014-2020年大陆与全球智能手机出货量对比分析(单位：百万部，%)
图表43：2014-2020年全球平板电脑市场出货量(单位：百万台)
图表44：2011-2020年集成电路生产环节产值占比图(单位：%)
图表45：2009-2020中国集成电路封装行业相关专利申请数量变化表(单位：个)

图表46：2008-2020年中国集成电路封装行业相关专利公开数量变化表(单位：个)
图表47：截止到2020年9月专利数量排名前十集成电路封装行业技术说明(单位：个，%)
图表48：截止到2020年9月我国集成电路封装行业专利申请人排名前十情况(单位：个，%)
图表49：树脂粘度变化曲线图
图表50：后固化时间与抗弯强度关系曲线图(单位：h，Mpa)

图表51：切筋凸模的一般设计方法
图表52：管控影响开裂的因素的方法分析
图表53：BGA封装技术特点分析
图表54：BGA封装技术分类
图表55：PBG A(塑料焊球阵列)封装
图表56：CMMB芯片产业链示意图
图表57：SIP产品应用领域分析
图表58：SOP封装产品
图表59：SOP封装技术特点分析
图表60：QFN生产工艺流程图
图表61：MCM封装分类
图表62：MCM封装产品需求拉动因素分析
图表63：CSP封装产品特点分析
图表64：CSP封装分类
图表65：几种类型CSP结构组成图
图表66：晶圆级封装(WLP)简介
图表67：晶圆级封装主要特点
图表68：3D封装方法分析
图表69：3D封装方法分析
图表70：2016-2020年中国电子计算机整机产量(单位：万台，%)
图表71：2016-2020年全球IT支出(单位：十亿美元，%)
图表72：2011-2019年我国通信设备制造行业收入及增长趋势(单位：亿元，%)
图表73：2011-2019年我国通信设备制造行业销售利润与利润总额(单位：亿元，%)
图表74：2012-2019年中国变频器行业销售收入及增长趋势(单位：亿元，%)
图表75：2012-2019年中国3D打印市场规模走势图(单位：亿美元，%)
图表76：2011-2020年中国工业控制类集成电路市场规模走势图(单位：亿元，%)
图表77：2011-2020年中国汽车产量及走势图(单位：万辆，%)
图表78：中国汽车电子市场主要影响因素分析
图表79：2011-2019年我国医疗器械制造行业收入与产值规模(单位：亿元，%)
图表80：2011-2019年我国医疗器械制造行业销售利润与利润总额(单位：亿元，%)
图表81：集成电路封装技术在医疗电子领域应用分析
图表82：2020年全球前十大封测厂商排名预测(按销售收

入) (单位: 百万人民币, %) 图表83: 各种电子产品的介电常数 图表84: DNP将部件内置底板“B2it”薄型化 图表85: “MEGTRON4”的电气特性和耐热性 图表86: 国际集成电路扶持措施借鉴 图表87: 台湾日月光投资控股股份有限公司基本信息表 图表88: 台湾日月光集团组织架构图 图表89: 2012-2020年台湾日月光集团经营情况分析 (单位: 百万新台币, %) 图表90: 2015-2020年力成科技营收情况 (单位: 百万新台币) 图表91: 中国集成电路封装测试行业企业类别图 图表92: 集成电路封装行业上游议价能力分析图 图表93: 集成电路封装行业下游议价能力分析图 图表94: 集成电路封装行业潜在进入者威胁分析图 图表95: 集成电路封装行业替代品威胁分析图 图表96: 中国集成电路封装行业竞争强度总结图 图表97: 2019年中国集成电路封装行业制造商销售收入排名前十位 (单位: 亿元, %) 图表98: 上海华岭集成电路技术股份有限公司发展简况表 图表99: 截至2019年底上海华岭集成电路技术股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (单位: %) 图表100: 2016-2020年上海华岭集成电路技术股份有限公司主要经营指标分析 (单位: 万元) 图表101: 2016-2020年上海华岭集成电路技术股份有限公司盈利能力分析 (单位: %) 图表102: 2016-2020年上海华岭集成电路技术股份有限公司运营能力分析 (单位: 次) 图表103: 2016-2020年上海华岭集成电路技术股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍) 图表104: 2016-2020年上海华岭集成电路技术股份有限公司发展能力分析 (单位: %) 图表105: 上海华岭集成电路技术股份有限公司产品发展情况图 图表106: 上海华岭集成电路技术股份有限公司发展优劣势图 图表107: 山东齐芯微系统科技股份有限公司发展简况表 图表108: 截止到2020年上半年山东齐芯微系统科技股份有限公司股权结构图 图表109: 2015-2020年山东齐芯微系统科技股份有限公司主要经营指标分析 (单位: 万元) 图表110: 2015-2020年山东齐芯微系统科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %) 图表111: 2016-2020年山东齐芯微系统科技股份有限公司运营能力分析 (单位: 次) 图表112: 2015-2020年山东齐芯微系统科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍) 图表113: 2016-2020年山东齐芯微系统科技股份有限公司发展能力分析 (单位: %) 图表114: 山东齐芯微系统科技股份有限公司产品发展情况图 图表115: 山东齐芯微系统科技股份有限公司发展优劣势图 图表116: 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司发展简况表 图表117: 截至2019年底江苏钜芯集成电路技术股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 (单位: 元, %) 图表118: 2016-2020年江苏钜芯集成电路技术股份有限公司主要经营指标分析 (单位: 万元) 图表119: 2016-2020年江苏钜芯集成电路技术股份有限公司盈利能力分析 (单位: %) 图表120: 2016-2020年江苏钜芯集成电路技术股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)